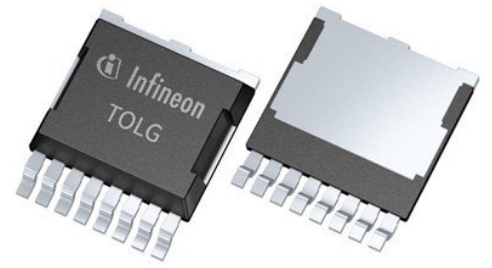


OptiMOS™ 5 パワーMOSFET 150 V、TOLGパッケージ

TOLGは、TOLxファミリーに追加された新しいパッケージで、より優れた熱サイクルオンボード (TCoB) 性能を提供します。このパッケージは、TO-リードレス (TOLL) と同じ大電流、低背の特徴を備えています。TOLGはTO-リードレスのフットプリントに互換性があり、高い温度サイクル耐量のガルウィングリードを備えています。



主な特長

- > クラス最高の技術
- > 高い定格電流
- > 低リンギング、低電圧オーバーシュート
- > D²PAK 7ピンに比べボード面積を60%削減
- > ガルウィングリード

主な利点

- > 高い性能
- > 高いシステム信頼性
- > 高効率、低EMI
- > 高い電力密度
- > 高い熱サイクル (TCoB)

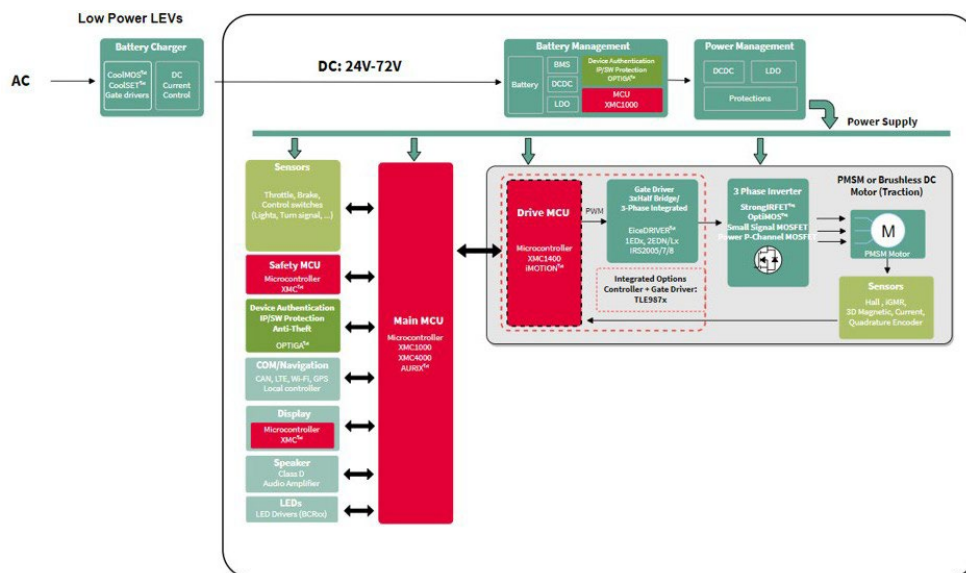
競合製品に対する優位性

- > AI-IMS基板は、TOLLパッケージやIPC-9701規格よりも優れた熱サイクル (TCoB) です。

対象アプリケーション

- > モーター制御
- > Eスクーター
- > バッテリーマネジメント
- > 小型電気自動車
- > 電動工具 / 園芸工具

ブロック図



製品関連情報/オンライン サポート

[製品ファミリーページ](#)

製品概要およびユーザーマニュアルへのリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
IPTG039N15NM5ATMA1	SP005676943	PG-HSOG-8
IPTG044N15NM5ATMA1	SP005676948	PG-HSOG-8
IPTG054N15NM5ATMA1	SP005676952	PG-HSOG-8
IPTG063N15NM5ATMA1	SP005676956	PG-HSOG-8

【OptiMOS™ 5 パワー-MOSFET 150 V、TOLGパッケージ】

FAQ

➤ **Why would a customer use a TOLT device versus a traditional TOLL device?**

In applications where the temperature cycles regularly over a wide range (for example 25°C to 100°C) and where aluminum insulated metal substrate is used in place of PCB materials such as FR4. TOLG also takes up significantly less board area than other SMD power packages such as D2PAK. This enables the power density achieved with TOLL with the mechanical reliability of D2PAK.

➤ **Why are gullwing leads an advantage?**

The TOLG gullwing leads are designed to bend and flex as the during the temperature cycle to alleviate mechanical stress on the solder joints caused by expansion and contraction of the substrate.